



证券代码：300567

证券简称：精测电子

编号：2026-006

武汉精测电子集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他_____
参与单位名称及人员姓名	长江证券王泽罡、倪蕤；民生证券周晓萌；国泰基金邓时锋、孙朝晖、郑有为、仇新宇；中信建投刘纯、朱伟、汪洁、曹添雨；润晖投资潘岨；龙石资本陆杨；壹拾资产罗鹏巍；混沌天成资管周高鼎；嘉实新加坡陈颖灵、孙悦；彼得明奇资管林蔚先；利幄私募基金孟舒豪等 36 余人（排名不分先后）
时间	2026 年 7 月 21 日、2026 年 7 月 23 日
地点	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：刘炳华先生
投资者关系活动主要内容介绍	Q1：当前半导体行业情况以及公司半导体业务概况？ A：公司所处半导体量检测赛道当前整体国产化水平仍处于低位，国产替代空间广阔，先进制程相关设备国产化渗透率更是存在明显短板。未来数年内，国内设备厂商的核心发展主线，将持续围绕突破海外龙头垄断、抢占存量市场份额展开。 公司是国内半导体量检测设备领域领军企业，逐步形成在半导体检测前道制程、先进封装和后道检测及核心器件的全领域量检测技术产品布局，主营产品包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备和自动检测设备（ATE）等，用于晶圆加工、制造、封测环节的物理参数测量与电性性能检测，是先进制程良



率管控核心装备。

当前，半导体产业正逐步进入由 AI 算力基础设施、先进逻辑芯片、先进封装技术与高端存储器件共同驱动的新一轮上行周期。半导体产业上行周期的发展态势，直接带动了半导体量检测设备销售的增长。公司在先进逻辑和先进存储产线中多种关键量检测设备实现规模化交付。同时，在手订单相较于去年同期有明显的增长，部分主要订单情况如下：

公司于 2026 年 5 月 30 日披露了《关于签订日常经营性重大合同的公告》（公告编号：2026-069），公司控股子公司上海精测连续与同一交易对手方签订了多份销售合同，主要向客户出售膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备等半导体量检测设备，应用场景主要为先进存储等相关领域，合同累计金额约 5.16 亿元。

公司于 2026 年 6 月 26 日披露了《关于签订日常经营性重大合同的公告》（公告编号：2026-082），公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）与客户签订了销售合同，拟向客户出售明场缺陷检测设备，合同总计金额达到 1.35 亿元。

公司于 2026 年 7 月 17 日披露了《关于签订日常经营性重大合同的公告》（公告编号：2026-094），公司控股子公司上海精测与客户签订了销售合同，拟向客户出售膜厚系列产品、OCD 设备等半导体前道量检测设备，合同总计金额超 2.23 亿元；上海精测连续十二月内与该客户及其相关公司签订了多份销售合同，合同累计金额约 3.30 亿元（含本次签订）。

Q2：公司收购上海精测 41.17%股权进展情况如何？

A：公司已于 2026 年 7 月 16 日披露重大资产重组预案，拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买上海精测剩余 41.17%股权并配套募资，目前相关工作正在稳步推进，公司会严格按照信息披露的规定和要求及时披露后续进展。

上海精测目前作为公司控股子公司，主营业务为半导体前道



量检测设备的研发、生产及销售，为下游半导体晶圆制造厂商提供膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备和自动测试设备（ATE）等。本次交易完成后，上海精测将成为公司全资子公司，有利于进一步提高公司资产质量、增强业务上的协同性，公司持续经营能力和核心竞争力将得以进一步提升，并促进公司业务进一步聚焦半导体领域。

Q3：公司半导体业务客户拓展及合作情况如何？

A：公司在半导体业务的客户涵盖中芯国际、华虹集团、合肥长鑫、晶合集成等国内大部分主流晶圆厂。公司与多家头部晶圆厂商建立深度长期合作，主力产品已实现批量落地并获得重复性订单，同步跟进客户扩产与验证。国内新建晶圆产线国产化需求旺盛，依托完整产品布局与自主供应链优势，公司客户合作规模持续扩大，公司对后续客户拓展及订单增长充满信心。

Q4：武汉精鸿后道电测的进展情况如何？

A：公司聚焦 ATE 领域持续深耕，构建起覆盖先进存储和 SOC（系统级芯片）全场景测试体系，为不同领域客户提供定制化、高效可靠的系统测试解决方案。面向先进存储芯片，可提供集成 BI（Burn-In）测试、CP（Chip Probing）测试和 FT（Final Test）测试于一体的多场景测试方案，全面支持最新的 DDR5/LPDDR5/NAND FLASH/UFS 等多种存储器芯片。同时针对 AI 领域的高带宽存储（HBM），推出 JH5520 HBM BI 测试系统，精准满足高端存储测试需求。面向系统级芯片，覆盖 50W~1000W 功率级别的芯片功能、性能及可靠性的测试。相关产品进展如下：

①主要应用于存储领域

BI 产品线覆盖了 FLASH 和 DRAM 类，目前已适配 ONFI 5.0、UFS3.1/UFS4.1 以及 DDR4/DDR5/LPDDR4/LPDDR5 等各类主流存储器件的高速老化测试，实现多家客户重复订单。

公司同时开发针对下一代的高端存储如



DDR6/LPDDR6/ONFI6.0 测试的支持，并已配合客户开始验证。

FT 产品主要针对 FLASH 和 UFS 类，目前已适配 ONFI5.0、UFS3.1、UFS4.1 器件，并完成国内头部大客户批量出货。当前公司正在开发适用于下一代高速嵌入式存储（UFS5.0）的 FT 设备。

CP 产品目前已成功导入国内 FLASH 客户量产产线，并拓展到微显示（Micro LED）客户量产产线，已出货国内主要客户。

Q5：先进封装行业红利下，公司对应检测设备有无相关布局？

A：在先进封装量检测领域，公司于 2024 年 3 月通过投资湖北星辰技术有限公司（以下简称“湖北星辰”）深度布局半导体先进封装领域，湖北星辰当前在高密度先进封装领域通过自主创新实现技术自主可控，关键指标达到国内领先水平。湖北星辰已建成 12 英寸集成电路先进封装研发线，正在建设量产产线，并同步推进产品研发与客户导入。湖北星辰未来将抢抓芯片产业快速发展窗口期，持续提升技术水平和服务能力，为客户提供一站式先进封装解决方案，助力先进封装产业高质量发展。

随着先进封装装备技术快速迭代，部分前道工艺向封装环节延伸，拉动半导体前道量检测、刻蚀、薄膜沉积、键合等设备的需求。面对 2.5D/3D 等先进封装挑战，公司现有前道量检测设备（主要包括膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备、明场光学缺陷检测设备等核心产品，具体详见前道量检测设备相关产品情况）已全部导入先进封装产线。

此外，公司晶圆外观检测设备主要专注于 CMOS 图像传感器、AR/VR、Logic、MEMS、Memory、RF、Power、FOWLP、WLCSP、Bumping、Chiplet 等先进封装工艺的有图形硅晶圆和无图像玻璃晶圆检测，已完成小批量出货，目前正在积极开发面向先进制程的 3D 量测，并与国内头部客户进行紧密验证测试。针对晶圆亚微米级缺陷进行检测与量测，集成高精度明暗场成像技术和专业缺陷检



精测电子投资者关系活动记录表（2026 年度）

	测算法，同时可扩展升级到晶圆 Bumping 及 Mirco-LED 3D 量测，有效服务客户提升制造能力指数与生产效率，精准适配先进封装快速发展带来的复杂缺陷检测需求。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 7 月 23 日